

2016

- (1) M. Eberhardt: Blog „HOOD beteiligt sich am BMBF Forschungsvorhaben autoSWIFT,“ HOOD GmbH, 15 Dezember 2015. [Online]. Available: <http://blog.hood-group.com/blog/2015/12/15/hood-beteiligt-sich-am-bmbf-forschungsvorhaben-autoswift/>. [Zugriff am 1 Juli 2016].
- (2) S. Reiter, J. Novacek, A. Viehl und M. Eberhardt: Vortrag „autoSWIFT - Schnellere Innovationszyklen für Elektroniksysteme entlang der Automobilwertschöpfungskette,“ in REConf 2016, München, 29 Februar 2016.
- (3) J. Beister, W. Finger, F. Ellinger, D. Fritsche, R. vanBentum, M. Wiatr und S. Kolodinski, „Schnelle Entwicklungszyklen bei Leading-Edge Technologien für Automotive durch geeignete Methoden der Technologie- und Risikobewertung“ EDA-Workshop 2016
- (4) M. Ammer, B. Deutschmann, M. Mayerhofer, „Obstacles in Predicting ESD Robustness according to ISO10605 of Electronic Systems with Automotive Examples“, Smart Systems Integration 2016, München, 09. März 2016.
- (5) M. Ammer, „Ideas to make the SEED Approach more practically usable for System Designers“, International ESD Workshop 2016, Tutzing, 18. Mai 2016.
- (6) L. Endriss und M. Eberhardt: Artikel „Warum erfolgreiches RE von einer Weiterentwicklung der Organisationsform abhängt“, SIGS Datacom: Objekt Spektrum Online Themen Special Requirements Engineering, 23 Juni 2016. [Online]. Available: http://www.sigs.de/public/ots/2016/OTS_RE_2016/endriss_eberhardt_OTS_RE_16.pdf. [Zugriff am 1 Juli 2016].
- (7) L. Endriss und M. Eberhardt: Blog „autoSWIFT: Was können wir zur Beschleunigung von Innovationen aus dem Agilen Manifest lernen?“, HOOD GmbH, 28 Juni 2016. [Online]. Available: http://blog.hood-group.com/blog/2016/06/27/team_agile-transition-ist-dran-3/. [Zugriff am 28 Juni 2016].
- (8) L. Endriss und M. Eberhardt: Blog „Können mit den Organisationsstrukturen des Industrialisierungszeitalters die Herausforderungen der Informationsgesellschaft des Wissenszeitalters gemeistert werden?“, HOOD GmbH, 26 Juli 2016. [Online]. Available: <http://blog.hood-group.com/blog/2016/07/26/koennen-mit-den-organisationsstrukturen-des-industrialisierungszeitalters-die-herausforderungen-der-informationsgesellschaft-des-wissenszeitalters-gemeistert-werden/>. [Zugriff am 28 Juli 2016].
- (9) A. Kress: „Massiv Parallel und Massiv Agile – Das autoSWIFT Forschungsvorhaben beschleunigt massiv“, 21. September 2016, Automotive Software Kongress, Landshut, <http://www.automotive-software-kongress.de>
- (10) C. Forster, S. Buschhorn, M. Rafaila, L. Maurer and G. Pelz. Cascading Metamodels from Different Sources for Performance Analysis of a Power Module, FDL, 2016, Infineon Technologies AG, Neubiberg, Germany; **accepted for publication** at FDL 2016
- (11) P. Stolz und K. Krennrich: Webinar „ISO26262 Agil? Aber sicher!“, 30. September 2016
- (12) M. Eberhardt, P. Stolz, L. Endriss, A. Kress: Vortrag „Beschleunigung von Innovationen durch eine neue Requirements Engineering Vorgehensweise“, 26. Oktober 2016, Tag des Systems Engineering, Herzogenaurach, <http://www.tdse.org>
- (13) Audi Mediacenter: Serientechnologie Audi connect, 29. August 2016, <https://www.audi-mediacycenter.com/de/techday-connectivity-6597/serientechnologie-audi-connect-6599>

2017

- (14) Jan Novacek, Alexander Viehl, Oliver Bringmann and Wolfgang Rosenstiel, "Reasoning-supported Robustness Validation of Automotive E/E Components", in

- 11th IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC), 2017, pages 220-226
- (15) Jan Novacek, Alexander Viehl, Oliver Bringmann and Wolfgang Rosenstiel, "Reasoning-supported Robustness Validation of Automotive E/E Components", in 11th IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC), 2017, pages 220-226
 - (16) S. Ottlik, C. Gerum, A. Viehl, W. Rosenstiel and O. Bringmann, "Context-sensitive timing automata for fast source level simulation", Design, Automation Test in Europe Conference Exhibition (DATE), march 2017, pages 512-517
 - (17) A. Hirler, J. Biba, A. Alsioufy, T. Lehndorff, T. Sulima, H. Lochner, U. Abelein, W. Hansch, "Umsetzung von Mission-Profiles in effektive Stressniveaus und -zeiten für die Zuverlässigkeit von Halbleiterbauelementen", Poster, edaWorkshop17, 08.05-10.05.2017, Dresden.
 - (18) T. Lehndorff, A. Alsioufy, A. Hirler, T. Sulima, H. Lochner, W. Hansch, "Strukturierte Halbleitertechnologiebewertung als Innovationsbeschleuniger im Automobil" EDA-Workshop 2017, Dresden, Poster
 - (19) A. Alsioufy, A. Hirler, T. Lehndorff, T. Sulima, H. Lochner, W. Hansch, "Entwicklung einer Technologie-BlackBox für die strukturierte Technologiebewertung in Automotive Anwendungen" EDA-Workshop 2017, Dresden, Poster
 - (20) M. Ammer, K. Esmark, A. Rupp, F. zur Nieden, Y. Cao, M. Sauter, L. Maurer, "Advanced Behavior Modeling of ICs for System-ESD Simulation with Destruction Limits in SPICE", International ESD Workshop 2017, Lake Tahoe, CA, 10. Mai 2017.
 - (21) T. Lehndorff, A. Alsioufy, A. Hirler, T. Sulima, H. Lochner, W. Hansch "autoSWIFT: Absicherung neuer Automotive-Anforderungen durch strukturierte Halbleiter-Technologiebewertung" Automotive meets Electronics 2017, Dortmund. VDE, GMM-Fb. 87: AmE 2017, ISBN 978-3-8007-4369-8, Poster mit Paper
 - (22) T. Lehndorff, M. Eberhardt, H. Lochner, G. Jerke, A. Alsioufy, A. Hirler, T. Sulima, W. Hansch "REConf 2017: Wie muss sich das Zusammenspiel von Requirements Engineering und den anderen Systems Engineering-Disziplinen im Produktentstehungsprozess entlang der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie für die Zukunft aufstellen?" REConf 2017, München, <https://www.hood-group.com/reconf/archiv/reconf-2017/agenda> Vortrag
 - (23) A. Hirler, J. Biba, A. Alsioufy, T. Lehndorff, T. Sulima, H. Lochner, U. Abelein, W. Hansch, "Evaluation of effective stress times and stress levels from mission profiles for semiconductor reliability", 28th European Symposium on Reliability of Electronic Devices, Failure Physics and Analysis ESREF 2017, 25.09.-28.09.2017, Bordeaux, France.
 - (24) Jonas Stricker, Benno Köppl, Jérôme Kirscher, Thomas Nirmaier, Linus Maurer, Georg Pelz: "Multi-Objective Optimization based Development of Power Electronics for Automotive Applications", Forum on specification & Design Languages (FDL) 2017
 - (25) C. Forster, M. Harrant, J. Kirscher, L. Maurer and G. Pelz. Error Propagation for Cascading Metamodels Applied on an Automotive Electric Drive Application, FDL, 2017, Infineon Technologies AG, Neubiberg, Germany, Forum on specification & Design Languages (FDL) 2017
 - (26) M. Ammer, K. Esmark, F. zur Nieden, A. Rupp, Y. Cao, M. Sauter, L. Maurer, "How to build a Generic Model of complete ICs for System ESD and Electrical Stress Simulation?", 39th Annual EOS/ESD Symposium, Tucson, AZ, 13. September 2017.
 - (27) C. Forster, J. Kirscher, R. Schaller, S. Simon, L. Maurer, G. Pelz. Lifetime Modeling for a Simulative Evaluation of Package Reliability in an Automotive Application, CAS, 2017, Infineon Technologies AG, Neubiberg, Germany, **accepted for publication** at CAS 2017
 - (28) M. Ammer, K. Esmark, F. zur Nieden, A. Rupp, Y. Cao, M. Sauter, L. Maurer, "Simulation of System Level ESD robustness using advanced behavioral IC models under consideration of PCB parasitics", 15. ESD-Forum, München, 25. Oktober 2017.

- (29) Andreas Krinke, Lei Lei, Jens Lienig, „Predictive System-Level Constraint Verification and Optimization“, Zuverlässigkeit und Entwurf (ZuE), September 2017

2018

- (30) Manuel Harrant, Thomas Nirmaier, Georg Pelz, Bjoern Eversmann, „Automotive supply line robustness incorporating hardware-embedded wavelet filters“, Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen (TuZ), Freiburg, 5. März 2018
- (31) Zhaofei Feng, Mingkang Li, Martin Stolz, Martin Kunert, Werner Wiesbeck „Lane Detection with a high-resolution automotive Radar by introducing a new Type of Road Markers“, Publikation in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
- (32) Zhaofei Feng, Martin Stolz, Mingkang Li, Martin Kunert, Werner Wiesbeck „A Novel Lane Detection Method for Automotive Radars based on a New Type of Road Markings“, ICMIM 2018, München, 16-18 April 2018
- (33) Zhaofei Feng, Martin Kunert, „Automotive Radars on the move“, European School of Antennas 2018 | Radar 2020, KIT Karlsruhe, 7-11 Mai 2018
- (34) V. Meyer zu Bexten, M. Tristl, P. Tavares: „Constraint-Aware Simulation with Virtuoso ADE Checks/Asserts“, CDNLive EMEA 2018, München, 7. Mai 2018.
- (35) A. Ahari, J. Novacek, A. Viehl, O. Bringmann, W. Rosenstiel, „CTEF: Collaborative Technology Evaluation Framework“, International Symposium on Systems Engineering (ISSE), 2018
- (36) J. Novacek, A. Ahari, A. Cornaglia, F. Haxel, A. Viehl, O. Bringmann, W. Rosenstiel, “Ontology-supported Design Parameter Management for Change Impact Analysis“, SEAA 2018
- (37) A. Ahari, A. Viehl, O. Bringmann, W. Rosenstiel, „Mission Profile-based Assessment of Semiconductor Technologies for Automotive Applications“, Microelectronics Reliability, 91, pp.129-138.
- (38) E. Bektas, K. Broermann, S.P. Brumm, G. Pecanac, S. Rzepka, C. Silber, B. Wunderle, „Fatigue Fracture Toughness of Lead Frame Molding Compound Interface“, ESTC, Dresden, 18-21 September 2018
- (39) Jonas Stricker, Benno Koeppel, Andi Buzo, Jerome Kirscher, Linus Maurer and Georg Pelz "Efficient simulative Pass/Fail Characterization applied to automotive Power Steering", Artificial Intelligence for Industries (AI4I), Laguna Hills, nominated for best paper award
- (40) Jonas Stricker, Clemens Kain, Andi Buzo, Jerome Kirscher, Linus Maurer, Georg Pelz, "Fault Impact Assessment for Automotive Smart Power Products in an Electric Power Steering Application", International Semiconductor Conference (CAS), Sinaia, best paper award
- (41) Jonas Stricker, Clemens Kain, Jerome Kirscher, Andi Buzo, Linus Maurer, Georg Pelz, " Semiconductor Component Fault Assessment and Probability Impact Estimation on Application Level", Nordic Circuits and Systems Conference (NORCAS), Tallinn
- (42) U. Abelein, "Robustness Validation in Context of the AEC-Q100/101 Appendix 7", ECPE Workshop - Reliability Engineering - 10 Years Robustness Validation, 24.-25.01.2018, Leinfelden-Echterdingen, Germany.
- (43) U. Abelein, "Extended Lifetime Qualification based on Standard Mission Profiles", 2018 AEC Annual Reliability Workshop, 24.-26.04.2018, Novi (MI), USA.
- (44) U. Abelein, "Extended Lifetime Qualification based on Standard Mission Profiles", VDE - ITG Fachgruppe 8.5.6 Nutzertreffen, 08.-09.05.2018, Neubiberg, Germany
- (45) U. Abelein, "Challenges of Semiconductor Product Qualification for Extended Automotive Requirements", IPC Automotive Electronics Forum, 04.-05.06.2018, Nürnberg, Germany.
- (46) U. Abelein, "Extended Lifetime Qualification based on Standard Mission Profiles", 1st European AEC Reliability Workshop 2018, 16.-17.10.2018, München, Germany.

- (47) M. Ammer, A. Rupp, Y. Cao, C. Russ, M. Sauter and L. Maurer, "Modeling the Transient Behavior of MOS-Transistors during ESD and Disturbance Pulses in a System with a Generic Black Box Approach," 2018 40th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD), Reno, NV, USA, 2018, pp. 1-7.
- (48) C. Russ, M. Ammer and K. Esmark, "Predicting System Level ESD Robustness Using a Comprehensive Modelling Approach," 2018 40th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD), Reno, NV, USA, 2018, pp. 1-10.
- (49) M. Ammer, A. Rupp, Y. Cao, M. Sauter and L. Maurer, "Bringing the SEED Approach to the Next Level: Generating IC Models for System ESD and Electrical Stress Simulation out of Design Data," IEEE Trans. Electromagn. Compatibilit., accepted for publication, **currently under revision**
- (50) M. Sniegucki, A. Schmid, H. Oechsner „Präventive Vibrationswirkkette mit Prognosemodellen zu schnelleren Innovationszyklen“ 8. VDE/ZVEI Symposium Mikroelektronik 2018, Berlin, Poster
- (51) Helmut Lochner, Göran Jerke, Holger Schnidt, Maciej Wiatr “autoSWIFT - Innovative Technologien schneller im Fahrzeug!“ Paneldiskussion EDA-Workshop 17.05.2018 Hannover
- (52) H. Lochner „Need for extended MP-based AEC Quality grades“ 1st Reliability AEC Workshop, München 17.10.2018
- (53) H. Lochner “autoSWIFT - Schnellere Innovationszyklen für Elektroniksysteme entlang der Automobilwertschöpfungskette“ Poster 8. VDE/ZVEI-Symposium Mikroelektronik, 06.11.2018, Berlin
- (54) H. Lochner “autoSWIFT - Schnellere Innovationszyklen für Elektroniksysteme entlang der Automobilwertschöpfungskette“ Elevator Pitch 8. VDE/ZVEI-Symposium Mikroelektronik, 06.11.2018, Berlin
- (55) A. Hirler, A. Alsioufy, T. Lehndorff, H. Lochner, S. Simon, T. Sulima, W. Hansch, "Mehrdimensionale Mission-Profiles - Berechnung effektiver Stressoren", Poster, edaWorkshop18, 16.-17.05.2018, Hannover.
- (56) A. Hirler, A. Alsioufy, J. Biba, T. Lehndorff, D. Lipp, H. Lochner, M. Siddabathula, S. Simon, T. Sulima, M. Wiatr, W. Hansch, "Alternating Temperature Stress and Deduction of Effective Stress Levels from Mission Profiles for Semiconductor Reliability", IEEE International Reliability Physics Symposium IRPS 2019, 31.03.-04.04.2019, Monterey, California, USA. **submitted**

2019

- (57) A. Cornaglia, A. Viehl, O. Bringmann, W. Rosenstiel, „SIMULTime: Context-Sensitive Timing Simulation on Intermediate Code Representation for Rapid Platform Explorations“, ASP-DAC 2019, **accepted for publication**
- (58) A. Cornaglia, MD H. Shakib, A. Viehl, O. Bringmann, W. Rosenstiel, „MODELTime: Fully Automated Timing Exploration of Simulink Models for Embedded Processors“, AmE2019, **accepted for publication**

Stand: 23.11.2018